

2020年12月9日

セミコンジャパン 2020 VIRTUAL に出展します

— デジタル化に貢献する ICT 材料を展示 —

(2020年12月11日～18日、オンライン)

三井化学株式会社（所在：東京都港区、社長：橋本 修）は、2020年12月11日（金）～18日（金）にオンラインで開催される「セミコンジャパン 2020 VIRTUAL」に出展いたします。

今回、開発中の高耐熱・絶縁インクジェット材料、高耐熱・環状オレフィンポリマー「ギガフリーク™」を出展します。



【参加登録フォーム】

<https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register>

■ 展示内容

テーマ	展示内容	特長
(インクジェット工法) プリントド・エレクトロニクス Additive Manufacturing	高耐熱・絶縁インクジェット材料	高耐熱 無溶剤 UV硬化可能 安定した分散特性
	エレファンテック社との 戦略連携の取組紹介	
5G 通信 次世代パッケージ	高耐熱・環状オレフィンポリマー 「ギガフリーク™」	高周波基板や絶縁フィルム向け 高耐熱 低誘電

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

三井化学株式会社 コーポレートコミュニケーション部 (TEL : 03-6253-2100)